

致 To : 各會員

編號 Ref. no. : M-12-067

由 From : HKPCA

日期 Date : 2012年6月25日

## 2012年07月份培訓課程 2012 July Training Course

課題 Topic:	線路板金屬表面處理技術與組裝應用 – 化學鍍金與化學鍍鈀金 Surface finishes technology and assembly application – ENIG and ENEPIG
日期 Date:	2012年07月27日 (星期五) / July 27, 2012 (Friday)
時間 Time:	2:00-5:00 PM
地點 Venue:	東莞市富盈酒店五樓多功能廳清圓房 Qing Dynasty Hall on 5th floor, Chinese Hotel, Dongguan (中國廣東東莞廣深高速公路東莞出口東莞大道交匯處) GZ- SZ Highway, Dongguan Exit, Dongguan Guangdong.
培訓目的 Training objective:	提供全方位的綫路板表面處理基本知識，並深入了解對化學鍍金與化學鍍鈀金的化鍍製程技術，培養學員正確的焊錫可靠度觀念，期待能對綫路板廠製做出高可靠性的金屬表面處理綫路板有所助益。 Wide final finishes knowledge build-up can help engineers to understand ENEIG / ENEPIG technology and reliability deeply. It may contribute to PCB shops for manufacturing high quality of surface finish circuit boards.
課程內容 Course Content:	1. 各種表面處理技術比較包括低氰置換金技術介紹 PCB all final finishes technology benchmark and overview including cyanide less immersion gold technology 2. 化學鍍金與化學鍍鈀金的化學反應原理/製程管控/常見問題排除與組裝信賴度介紹 ENIG and ENEPIG technology introduction including reaction mechanism, process control, trouble shooting and assembly reliability. 3. 組裝焊錫性瞭解(含錫球推力/拉力失效分析, IMC)與助焊劑/錫膏影響介紹 Extensive knowledge of solder joint (ball shear, ball pull, fast speed ball shear) regarding to assembly process and flux/solder paste impact, IMC analysis during thermal aging. 4. 黑墊和鍍腐蝕原理與預防, 環境腐蝕性氣體對化學鍍金組裝信賴研究 Mechanism and solution for Ni corrosion of black Ni and Ni corrosion resistance to Selective ENIG/SO2/mixed corrosive flow gas 5. 技術討論與交流 Technical discussion and communication
培訓對象 Target Audience:	線路板製造/品保/研發工程師與經理 QC/manufacturing/R&D engineers and managers in PCB shops
講師 Resume of speaker:	李東三 畢業於台灣清華大學化學系與原子科學研究所，目前在陶氏化學電子材料，電子連接技術亞洲區，擔任產品經理，主要負責影像轉移、金屬表面處理、塑膠電鍍，已在陶氏化學服務超過九年。進陶氏化學之前服務於瑞士商Ciba公司五年，擔任電子材料台灣區技術服務經理與區業務經理。在更早之前的四年期間服務於工程公司，擔任化工廠與肥料廠建造專案工程師與專案經理。在過去約十九年間於工程與電子材料界的機會，有幸參與許多先進技術製程的開發與應用，並在塑膠電鍍(MID)、被動元件鍍錫、防焊綠油、光阻、製程藥水、內層棕化/黑化壓合與金屬表面處理工藝(無鉛噴錫、化學鍍金、化學鍍鈀金、有機保焊與化學銀金)有廣泛的研究和實務經驗。

<b>講 師 Resume of speaker:</b>	Mr.Simon Lee holds B.Sc. degree in Chemistry and M.S. degree in Nuclear Science from the National Hsing Hua University, Taiwan, R.O.C. Simon Lee is Asia Product Manager in the Interconnect Technologies group of Dow Electronic Materials. He is responsible for imaging, final finishes and MID (molded interconnect device) marketing of Dow Electronic Material, Asia. He has been with Dow for above 9 years. Prior to joining Dow, Mr. Lee was a sales head & technical service manager in Ciba Specialty Chemical company in Taiwan region. During his 19-year career in the chemical engineering and electronics industry, Simon has worked extensively with chemical engineering in PCB industry including soldermask, liquid photoresist, process chemicals, innerlayer bonding and final finishing technologies(HASL, lead free HASL, ENIG, ENEPIG,OSP, ASIG).	
<b>語 言</b>	中文 / Chinese	
<b>費 用 Fee:</b>	<p>本會會員 – 每位 HK\$330 , 或 RMB320 ( 含稅): 費用包括講義、茶點, 請於活動舉行前辦妥繳費事宜, 逾期作取消論。如屬同一公司多人報名, 可獲以下優惠 (此優惠只限公司會員):</p> <p>3 人至 4 人 – 每位 HK\$280 , 或 RMB270(含稅)</p> <p>5 人或以上 – 每位 HK\$220 , 或 RMB210(含稅)</p> <p>非本會會員 – 每位 HK\$500 , 或 RMB480 ( 含稅): 費用包括講義、茶點。</p> <p>Member - HK\$330, or RMB320 per head (including tax): The fee includes handouts and refreshments. Please settle the payment before the event, or reserved seats will be cancelled. If more than one people of the same company signed up for training, bulk discount will be offered (For corporate members only):</p> <p>3 to 4 persons- HK\$280, or RMB270 per head (tax included)</p> <p>5 or more persons - HK\$220, or RMB210 per head (tax included)</p> <p>Non-members - HK\$500, or RMB480 per head (including tax): fee includes handouts, refreshments.</p>	
<b>截止日期 Deadline:</b>	2012 年 07 月 23 日(星期一) / July 23, 2012 (Monday)	
<b>繳款辦法 Payment Method</b>	<p>人民币电汇：</p> <p>户 名：港粵綫路板科技咨询(深圳)有限公司</p> <p>开户行：招商银行股份有限公司深圳常兴支行</p> <p>帐 号：7559 1878 8810 201</p> <p>深圳办事处地址：中国广东省深圳市南山区桃园路 171 号深圳发展银行南山大厦 13A2 室</p>	<p>港幣電匯：</p> <p>銀行名稱：香港上海滙豐銀行有限公司</p> <p>帳戶名稱：香港綫路板協會有限公司</p> <p>帳戶號碼：469-089601-838</p> <p>銀行電匯編號：HSBCHKHHHKH</p> <p>香港辦事處地址：香港九龍觀塘成業街 7 號寧晉中心 22 樓 B 室</p> <p>Bank name : HSBC</p> <p>Bank A/C Name: Hong Kong Printed Circuit Association Ltd.</p> <p>Bank A/C No: 469-089601-838</p> <p>Swift Code: HSBCHKHHHKH</p> <p>Hong Kong Office Address: Unit B, 22/F., Legend Tower, 7 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, H.K.</p>
<b>查 詢 Enquiry:</b>	<p>深圳辦事處: 趙小姐 Lucy Zhao; Tel: (86) 755 8624 0033; Email:<a href="mailto:lucyzhao@hkpc.org">lucyzhao@hkpc.org</a></p> <p>袁小姐 Susan Yuan; Tel: (86) 755 8624 1673; Email:<a href="mailto:susanyuan@hkpc.org">susanyuan@hkpc.org</a></p>	

# 回條 Reply Form

2012年07月份培訓課程

日期：2012年07月27日(星期五)

時間：14:00pm ~ 17:00pm

地點：東莞市富盈酒店五樓多功能廳清圓房

請於2012年07月23日(周一)前回覆

Please reply by July 23 (Monday), 2012

傳真 Fax : 755-86240022

電郵 Email : [Lucyzhao@hkpca.org](mailto:Lucyzhao@hkpca.org)

[Susanyuan@hkpca.org](mailto:Susanyuan@hkpca.org)

致：HKPCA/PRC 秘書處

本人/吾等希望參加2012年7月27日培訓課程

本人/本公司為HKPCA會員，會員編號：\_\_\_\_\_。

## 參加者詳情：

人數	參加者姓名(必填)		職位	參加培訓者 手機號(必填)	學歷(請選擇一項)			是否需要 培訓證
	英文	中文			預科或 以下	大專或 大學	碩士或 博士	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

## 說明：

- 1、需要培訓證的學員請在「是否需要培訓證」一欄中進行選擇，並填妥中英文名，無中文名的除外。
- 2、培訓證將在當次培訓課程結束後，發放給學員本人；若參加者有變動請於截止日期前通知本會。

對是次課程之期望（請務必填寫）： \_\_\_\_\_

其他： \_\_\_\_\_

費用：

參加人數共 \_\_\_\_\_ 人 X 每人港幣/人民幣 \$ \_\_\_\_\_ = 合共總額港幣/人民幣 \$ \_\_\_\_\_

備註：不設現場收費，煩請於課程至少三天前付清。

聯絡人資料：

公司名稱： \_\_\_\_\_

公司地址： \_\_\_\_\_

姓名： \_\_\_\_\_ 電話： \_\_\_\_\_

電郵： \_\_\_\_\_ 傳真： \_\_\_\_\_

**\*\*\*截止報名日期：2012年07月23日(星期一)\*\*\***